

# 95 전자부품산업 전망

조경수/삼성전기(주) 이사

## 1. 경영환경 전망

'95년 국내 전자부품산업은 전반적인 경기회복, 전자산업의 호황지속 등으로 플러스 요인이 될 것이나, 원자재 가격의 상승, 원高 진행, 금리인상 등은 마이너스 요인으로 작용할 전망이다.

円高에 따른 사업창출 기회, 기술혁신의 결과, 첨단부품 사업기회 확대, 정부의 산업정책 변화, 소재 및 부품산업을 적극 육성하는 방향으로 산업정책이 변화되고 있고 이동통신, 멀티미디어 등 첨단분야의 성장은 국내 전자부품산업의 호재요인으로 작용될 것이다.

그러나 日本 부품메이커의 동남아, 중국으로 Shift한 이후, 새로운 생산체제와 공급채널 구축에 성공하여 경쟁력이 회복되고 있다는 점과 동남아가 세계적 부품생산 기지로 부상하고 있다는 사실이다.

그리고 세트 업체들의 부품채용수 삭감추세 가속화 등이 위협

요인으로 작용할 전망이다.

## 2. 주요 세트 시장 전망

'95 세계 주요세트 시장은 AV 및 가전기기는 必需品化로 정착되어 AV기기는 2.5%, 에어컨이 6% 성장할 전망이다.

정보통신기기도 성장세를 지속하여 PC, 모니터, HHP, FAX는 10% 이상 성장할 전망이다.

또한 국내 세트산업은 수출이

부진한 반면, 내수는 활황이 예상된다.

AV, 가전기기는 円高효과로 수출환경이 악화될 것이며 내수 환경은 가격인하 효과로 가시화될 것이다.

PC, 주변기기는 OEM 물량이 축소될 것이며 정보화 투자가 지속될 것이다.

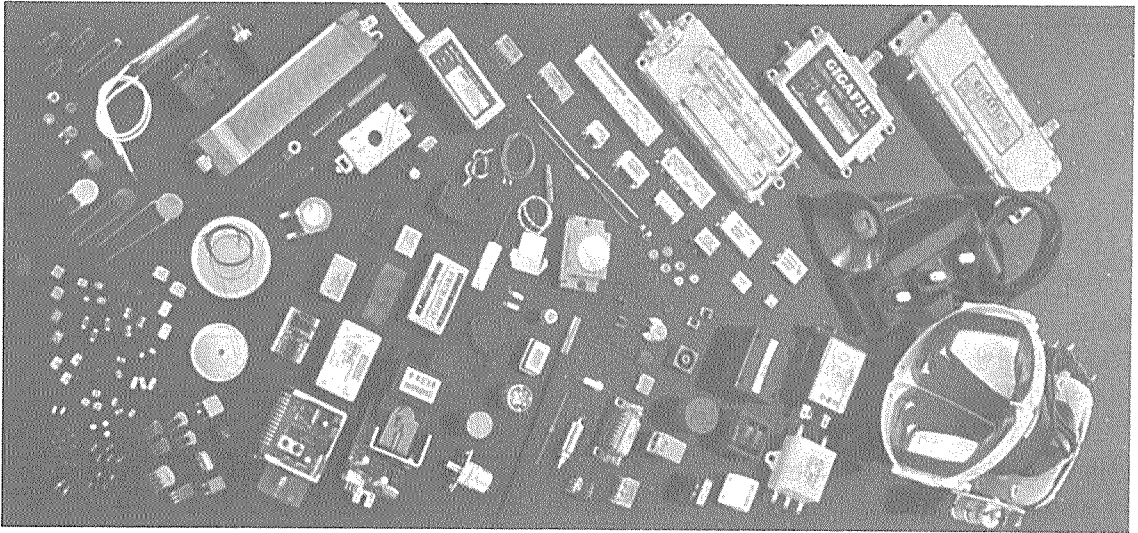
통신기기는 가격경쟁력이 약화되고 휴대폰 중심으로 활황을 보일 것으로 예측된다.

〈AV, 가전기기〉

품목	전년비성장률 10%
CTV	2.9 ← 94년 2.6 ← 95년
VTR	0.4 2.4
카세트	2.3 2.4
세탁기	1.3 1.6
에어콘	4.0 6.4

〈정보통신기기〉

품목	전년비성장률 10%
PC	14 12
모니터	11 10
HHP	20 17
FAX	14 13
자동차	5.5 5.7



〈주요 전자부품의 세계시장 전망〉

제 품		94년	95년	시 장 동 향
AV 부품	스 피 커	89,440만개 (4.5)	93,250만개 (4.3)	• 日포스타(中國), 松下部品(멕시코) 등 해외생산을 대폭 확대→가격경쟁 심화
	A - D E C K	24,800만개 (4.0)	25,770만개 (3.9)	• 중고급기종(LOGIC계통) 시장경쟁 치열 • 부품수 대폭삭감을 통한 저가격 경쟁
	V - H E A D	8,930만PAIR (2.5)	9,330만PAIR (4.4)	• 세트업계의 구입선 다변화 추세 뚜렷 • 공급과잉 지속으로 가격경쟁이 큰 부담
	전 자 식 T U N E R	15,470만개 (2.2)	15,860만개 (2.5)	• 中國메이커들이 수출시장에 본격 참여 • 東南亞向 수출시장이 호전 예상
DIS- PLAY 부품	브 라 운 관 D B Y F B T	14,530만개 (4.9)	15,190만개 (4.5)	• TV용 : 14, 20, 21"→25"수요증가 블록별 현지생산 확대 • MT용 : 14"→15, 17"로 SHIFT 시작
범용 부품	전 해 큰 텐 서	663억개 (6.1)	704억개 (6.2)	• 범용품 : 東南亞의 수요, 생산 급증 • 대형품 : SMPS를 따라 해외생산 본격화
	P C B	373억\$ (6.0)	397억\$ (6.4)	• Cost-Down위해 층수를 줄이는 경향이 정착→10층 이상은 수요감소 예상
	S M P S	100억\$ (9.4)	110억\$ (9.9)	• 韓國, 台灣, 홍콩업체의 日本系 세트업 체 공략이 본격화(PC용을 중심으로)
	H y b i r d I C	66억\$ (5.4)	70억\$ (5.8)	• 일반HIC 시장은 위축 • 통신용 Power HIC 시장이 호조
칩 부품	M L C C	1,570억개 (18.7)	1,790억개 (13.6)	• 칩화율 85% (일본) • 2012→1608로 본격이동, 1005비중 10%
	칩 탄 탈	146억개 (22.7)	162억개 (11.0)	• 칩화율 85% (일본) • B Size(3528)→A Size(3216) 이동중
	칩 저 항	2,010억개 (15.5)	2,210억개 (9.8)	• 칩화율 85% (일본) • 1005까지 실용화, 試作品수준 0804

### 3. 국내외 전자부품 시장전망

#### 1) 세계시장 전망

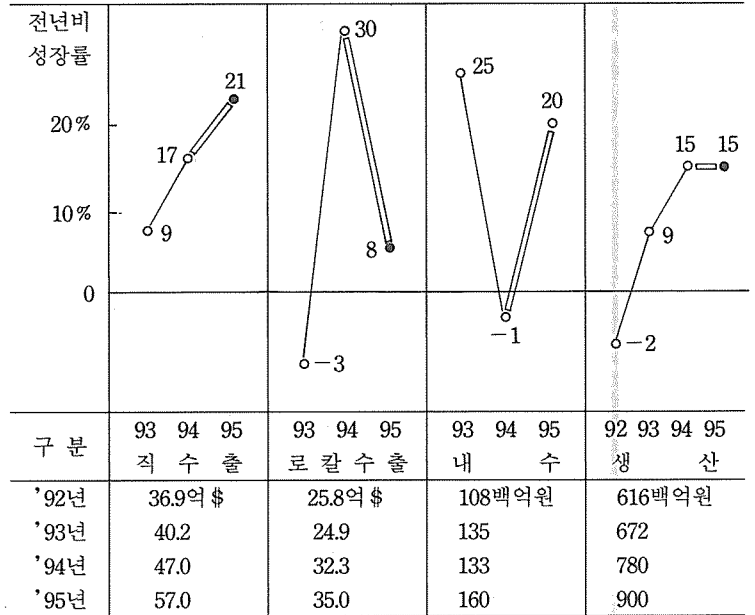
'95년도 세계 전자부품 시장은 범용 및 칩 부품이 성장을 주도할 것으로 보인다.

콘덴서, PCB, HIC 등은 6%, SMPS, 칩 저항 등은 10%, MLCC, 칩 탄탈 등은 10% 이상의 성장이 기대된다.

그러나 AV 및 Display 부품은 상대적으로 낮은 성장이 예상되는데 AV부품은 3~5% 성장, Display 부품은 5% 정도 성장이 예상된다.

품목별로 보면, AV부품중에서 전자식 튜너가 1억 5,860만개(2.5% 증가), 브라운관 DY FBT가 1억 5,190만개(4.5% 증가), 전해콘

〈국내 전자부품산업 전망〉



(註) 1. 반도체를 제외한 「電子部品」 기준(브라운관 포함)  
2. EIAK자료를 참고로 三星電機 작성

〈국내 생산·수출 전망〉

제 품		생 산 (억원)		수 출 (백만 \$)	
		'94년 예상	'95년 전망	'94년 예상	'95년 전망
AV 부품	• 스피커	2,420 (-8)	2,180 (-10)	170 (-20)	140 (-18)
	• 자기헤드	4,110 (2)	4,300 (5)	250 (-2)	250 (-)
	- Video 헤드	1,830 (37)	2,400 (31)	55 (67)	85 (55)
	• 전자식Tuner	1,460 (8)	1,550 (6)	67 (59)	85 (27)
	• 자기Tape	8,520 (1)	8,900 (4)	850 (3)	900 (6)
DISPLAY 부품	• 컬러브라운관	18,100 (14)	20,200 (12)	945 (9)	1,050 (11)
	• DY	1,630 (27)	2,000 (23)	57 (78)	80 (40)
범용 부품	• 콘덴서	6,100 (23)	7,300 (20)	230 (26)	300 (30)
	- 전해콘덴서	2,870 (19)	3,400 (18)	87 (28)	110 (26)
	• 저항기	1,770 (25)	2,200 (24)	65 (27)	78 (20)
	• 스위치	4,050 (91)	5,000 (23)	98 (66)	130 (33)
	• PCB	4,810 (47)	6,300 (30)	260 (56)	340 (31)
	• Hybrid IC	1,695 (4)	1,900 (12)	110 (12)	125 (14)
	• 소형모타	3,000 (12)	3,300 (10)	84 (-)	100 (19)
칩 부품	• MLCC	390 (75)	600 (54)	15 (146)	30 (100)
	• 칩탄탈콘덴서	136 (60)	200 (47)	7.6 (62)	12 (58)
	• 칩저항	190 (29)	240 (26)	7.7 (114)	15 (95)

(註) 1. 반도체를 제외한 「電子部品」 기준(브라운관 포함)  
2. EIAK자료를 참고로 三星電機 작성

덴서 704억개(6.2% 증가), PCB는 397억 달러(6.4% 증가), SMPS는 11억 달러(9.9% 증가), HIC는 30억 달러(5.8% 증가), 시장 규모를 보일 전망이다.

또한 MLCC는 1,790억개(13.6% 증가), 칩 탄탈은 162억개(11% 증가), 칩 저항은 2,210억개(9.8% 증가)에 달할 것으로 예측된다.

## 2) 국내 전자부품산업 전망

'94년도 국내 전자부품산업은 수출 호조에 힘입어 침체 국면에서 완전 탈피, 직수출이 17%, 로칼수출은 30% 증가한 것으로 나타났다.

그 결과, 생산이 전년대비 15% 증가한 7조 8,000억원에 달할 전망이다.

한편 95년도 전자부품산업도 이러한 추세로 세트업체의 수출침체로 로칼수출이 부진한 반면, 직수출과 내수가 각각 20% 증가하여 호황세를 주도할 전망이다.

그 결과, 생산은 9조원을 기록

	직수출	로칼수출	내수	생산
94년	호조	크게 호조	감소	호조
95년	호조	부진	크게 호조	호조

하여 전년대비 15% 증가할 것으로 예상된다.

## 3) 주요부품의 생산·수출 전망

품목별로는 스피커, 컴퓨터용 자기헤드, 전자식 Tuner, 자기 Tape 등 AV부품은 해외생산 확대로 국내 생산은 정체 또는 감소가 예상되나 Display 부품의 경우는 해외생산 확대와 함께 국내 생산도 안정 성장이 기대된다.

특히 범용부품과 칩 부품이 성장을 주도할 것으로 콘덴서, 스위치, PCB, 칩 저항 등이 20% 이상의 성장이 예상되며 MLCC, 칩 탄탈 등은 50% 이상의 성장이 예상된다.

## 4. 일본전자부품업계 동향

일본 전자부품 업체들의 최대 이슈는 일본 내에서만 생산 가능한 첨단부품을 개발해서 생산 공동화를 극복하자는 것이다.

현재 컬러 LCD, 이차전지가 대표적인 제품이지만 제3, 제4의 제품 즉 이동체통신, 멀티미디어 관련 제품 개발이 활기를 띠고 있다.

또한 일본내에서는 휴대전화,

GPS, PHS 등 기대상품 등장과 해외에서의 구미, 동남아 시장이 급속히 확대되는 등 이동체 통신 분야 사업을 확대하고 있다.

특히 미국 법인을 정보수집의 안테나로 활용 통신관련 기술분야를 대폭 강화하는 등 멀티미디어 분야 사업도 강화하고 있는 것을 주목해야 할 것이다.

일본 업체들의 해외생산 비율은 업계 전체로 '94년 40%에서 95년에는 50%로의 증가가 예측된다.

특히 중국 거점으로 한 해외생산 신증설이 늘어날 것이며 동남아 생산은 대폭적으로 증설될 것으로 보인다.

일본업체들은 Coile & Trans, 스피커, A-Deck, 자기헤드, 소형모터 등 50% 이상을 이미 해외생산하고 있으며 전품목으로 확대될 전망이다.

그러나 이러한 해외생산 확대가 가져온 것은 동남아산, 중국산과의 저가격이 불가피해져, 내외 가격차가 커지고 있다는 것이다.

따라서 일본 본사는 「이익없는 번영」이란 우려가 현실로 나타나고 있으며, 수익확보에 위기감을 초래하고 있는 것으로 보인다.